

Plasma Etching Fundamentals for Memory Devices

김완수 / SK hynix Inc.

메모리 반도체 소자의 고집적화와 함께 3D NAND와 같이 기존과는 다른 형태로 반도체 소자가 진화함에 따라 반도체 공정에도 지속적으로 변화가 일어나고 있다. 이러한 변화에 대응하기 위해 반도체 공정, 특히 Etch 공정의 중요성과 난이도가 계속 증가하고 있는 상황이다. 본 강의에서는 메모리 소자에 사용되는 Etch 공정에 대해 필수적으로 알아야 할 기본 개념을 소개하고 식각 대상 물질별 식각 Mechanism 이해 및 응용 방향에 대해서 다루고자 한다.